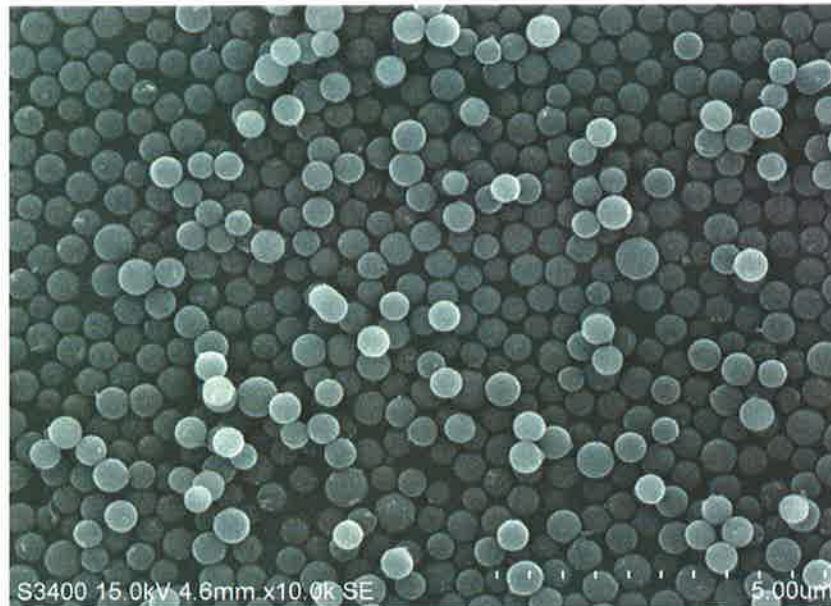


## 球状シリコンパウダー “MSP-SN05, SN08”



製品名	MSP-SN05	MSP-SN08
外観	白色粉末	白色粉末
平均粒子径(μm)	0.5	0.8

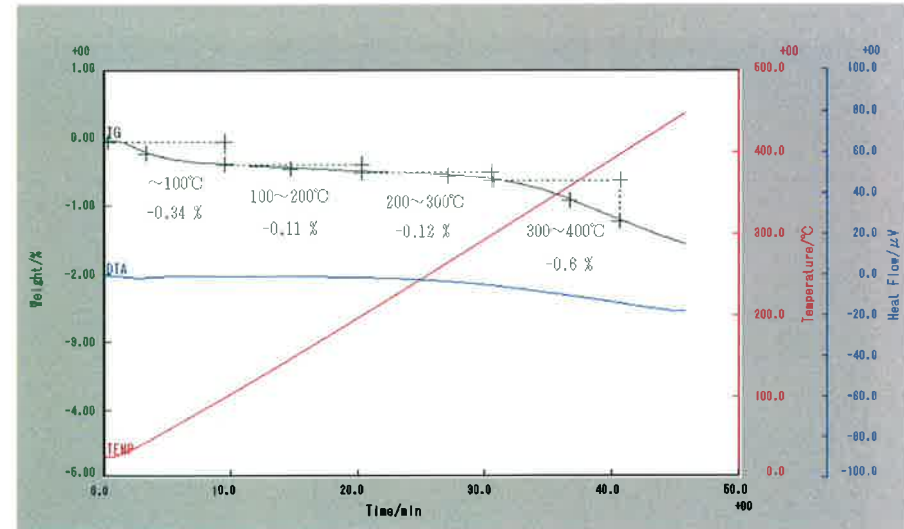
(規格値ではありません)

### ☆特徴

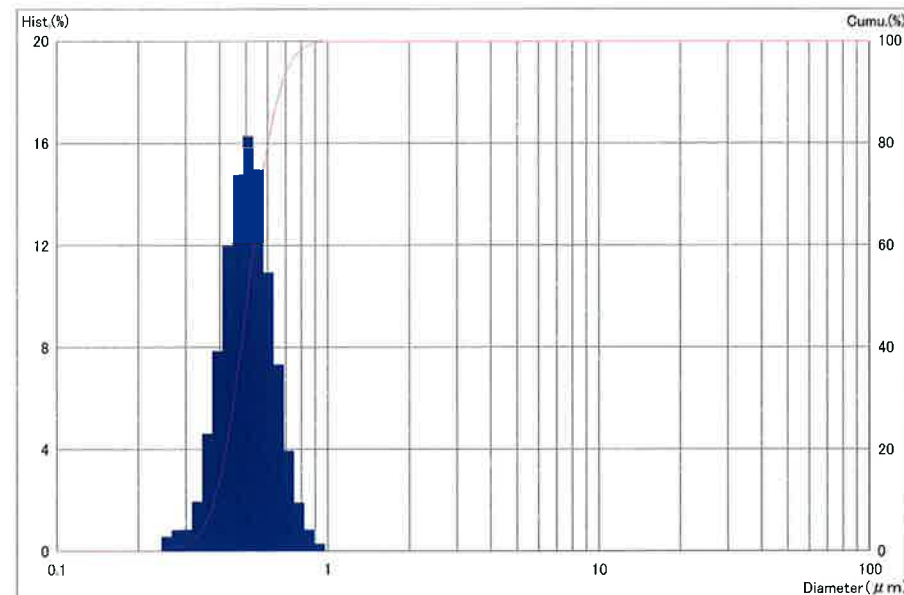
- 他の有機系微粒子に比べ耐熱性に優れている。
- 耐候性、耐酸性に優れ有機溶剤にも不溶。
- 絶縁性に優れている。

### ☆用途

- 液状封止材、アンダーフィル(熱応力緩和)
- インキ用途(タックフリー)



MSP-SN05 TG-DTA



MSP-SN05 粒度分布

お問い合わせ先: 日興リカ株式会社 新事業推進本部 担当: 水嶋

TEL: 03-5209-9866(直通) FAX: 03-5209-9874 E-mail: tmizushima@nikko-rica.co.jp